

「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」(事後評価)
今後の予定

平成 28 年 6 月 21 日 (火) 9:30~18:00
評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 28 年 6 月 23 日 (木)
質問票の提出 (評価委員)
提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 駒崎聰寛 宛
※質問票への回答 (推進部署・実施者) は 6 月 28 日 (火) までに評価部 駒崎へ提出

評価コメントの作成・取り纏め

平成 28 年 7 月 4 日 (月)
評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)
提出先: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 駒崎聰寛 宛

平成 28 年 7 月 20 日 (水) 頃まで
評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 28 年 7 月 27 日 (水) 頃まで
評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進部署・実施者に配布

評価コメント応答

平成 28 年 8 月 3 日 (水) 頃まで
推進部署・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進部署・実施者)

平成 28 年 8 月 9 日 (火) 頃まで
推進部署・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (分科会長・評価委員)

評価報告書の確定

研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。